

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-012

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 <u>（电话会议）</u>	
参与单位名称及 人员姓名	单位名称	姓名
	天风证券	李由
	东证资管	黄基力
	浙商资管	刘玮奇
时间	2021 年 11 月 9 日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书兼投资总监蒋云霞、证券事务代表施雨虹	
投资者关系活动 主要内容介绍	投资者参观了公司的产品展厅，并在公司会议室进行问答交流，具体内容如下：	

	1、公司有哪些成长空间？ 回复：随着移动、数据中心和云计算服务器、汽车和工业市场的 5G 连接、人工智能、深度学习、虚拟现实和其他新兴应用的激增，带动了芯片上游原材料超高纯溅射靶材需求的持续增长。同时，面对快速发展的国内市场，公司精密零部件、CMP 业务面临着较为有利的市场环境，有较大的成长空间。此外，伴随着技术的创新突破及迭代，平板显示产业链加速向中国大陆迁移，其市场规模增长可期，公司可转债募投项目的实施将就近为平板显示器制造商供应靶材及机台相关部件，有利于公司进一步扩大平板显示用高纯金属溅射靶材及相关机台部件的生产能力和市场占有率，提升公司盈利能力和综合竞争力。 2、请问公司在解决上游关键原材料方面有何举措？ 回复：公司主要通过实施募投项目及其他投资项目等向上游拓展靶材产业链的布局。 3、公司产能现状如何？ 回复：受益于市场需求强劲，公司订单处于相对饱和状态。公司目前主要通过改进与调整瓶颈工艺工序、建设智能化生产线等方式逐步提升产能。 4、公司可转债募投项目的进展情况如何？ 回复：公司本次可转债的募投项目是在惠州和武汉建设平板显示用靶材及部件生产基地，项目建设期为两年，目前正在按计划推进。对于项目的具体进展情况，公司将依规履行信息披露义务。 5、公司如何规划 CMP、零部件业务的未来发展？ 回复：目前，公司 CMP 业务销售规模逐年增长，正在积极发展中。公司和国内多家机台厂商合作，依托本身强大的
--	---

	机加工能力，开发机台使用的金属零部件，在新的业务领域拓展产品线。2021 年上半年，公司半导体精密零部件销售额已超过上年全年水平。公司新开发的各种精密零部件产品已经广泛用于 PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备，在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。未来，公司将充分利用技术、服务、市场等优势，积极拓展新客户。 6、公司的竞争优势体现在哪些方面？ 回复：经过多年产业积累和技术攻坚，公司产品已成功获得国际一流芯片制造厂商的认证，并在世界先端工艺实现批量供货。未来，公司将继续保持核心竞争力，通过专业的技术服务团队和技术支持体系，对客户需求形成快速反应，不断提升客户服务水平；通过持续的技术创新和新品研发，不断追踪国际先进技术节点；坚持“品质成就未来”，凭借严格的质量控制和完善的产品检测，保持产品质量优势，树立良好的品牌形象，为公司积累更多优质的客户资源、提升市场占有率夯实基础。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 9 日